

第 93 回マイクロ接合研究委員会
講演プログラム

13:00 ～ 13:20

マイクロ接合研究委員会におけるロードマップ

廣瀬 明夫（大阪大学）

13:20 ～ 14:00

高密度集積技術 「微細ピッチ電極間接続技術」

青柳 昌宏（（独）産業技術総合研究所）

14:00 ～ 14:40

異種材料接合技術 「導電性接着剤の概要」

小日向 茂（住友金属鉱山㈱）

14:40 ～ 15:00

---休憩---

15:00 ～ 15:40

環境調和型実装「低環境負荷プロセスの実現に向けた低温接合技術の開発」

作山 誠樹（㈱富士通研究所）

15:40 ～ 16:20

信頼性 「自動車電子実装における信頼性」

新帯 亮（㈱デンソー）

16:20 ～ 17:00

総合討論